

## 深圳佰维存储科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录汇总表

(2025年2月19日-2月21日)

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 专场机构交流会 <input type="checkbox"/> 其他 _____	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观
参与单位名称及人员姓名	西证创投 谢飞旺、西证创投 薛卓娅、沅途投资 陈阳、惠创投 邹奕、惠创投 廖子铠、广杰投资 杨浩杰、广杰投资 阮经天、华金证券 黎国栋、国信资本 徐晓光、国信资本 李关顺、财通基金 从昉昕、湾区创投 李志斌、佳都科技 林秀峰、佳都科技 陈阳、南传私募 涂鹏、南传基金 董思琦、山岳基金 傅浩、华泰联合 刘展鹏、前海方舟 化定奇、前海方舟 马康、国海创新资本 钱海霞、无锡创新投资 张宝丁、无锡创新投资 陈建军、恒泰证券 马冠东、吉富创投 罗华灶、南昌产投 徐晨洋、南昌产投 罗浩良、上海固信 杨灿、上海固信 沙涛、华宝万盈 朱望阳、华宝万盈 徐一丁、建投投资 王子宁、大家资产 张浩、大家资产 石泰华、博海基金 闫达、招商证券 蒋昕珊	
会议时间	2025年2月19日 10:30-11:30 2025年2月20日 13:00-16:00 2025年2月21日 13:00-16:00	
会议地点	佰维存储三楼会议室 佰维存储惠州封测制造中心二楼会议室	
上市公司接待人员姓名	公司管理层 董办工作人员	
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>Q1. 请问公司坚持研发封测一体化的布局，能够带来怎样的竞争优势？</b></p> <p>A1: 公司是业内最早布局研发封测一体化的企业，从2010年开始就自建封测能力，有十几年的积累沉淀，存储封测的技术能力达到国内领先、国际一流的水平。基于公司研发封测一体化的布局，公司存储器产品在智能可穿戴领域具有较强的竞争优势，能够在低功耗、快响应等方面进行固件算法优化设计的同时，通过先进封测工艺能力，助力产品的轻薄小巧。在产品交付过程中，面对客户的大批量交付、急单交付等需求，公司自主封测制造能力可以确保客户交期与产品品质。公司在现有技术基础上进一步布局晶圆级先进封测能力，不断提升技术壁垒。公司通过晶圆级先进封测制造项目构建晶圆级先进封测能力，一方面可以满足先进存储封装需求，为公司研发和生产先进存储产品构建技术基础，提供相关封装产能；另一方面可以与公司存储业务协同，服务公司客户对于存算合封业务的需求，为相关客户提供封测服务。</p> <p><b>Q2. 请问公司是否与华为在 HBM 领域有合作？</b></p>	

	<p>A2: 公司未与华为进行相关合作, 也无 HBM 产品。请各位投资者以公司公开披露信息为准。</p> <p><b>Q3. 请问公司 2024 年业绩表现如何? 主要有哪些增长原因?</b></p> <p>A3: 2024 年公司紧紧把握行业上行机遇, 大力拓展国内外一线手机和 PC 客户, 实现了市场与业务的成长突破, 产品销量同比大幅提升。根据公司发布的《2024 年年度业绩预告》, 2024 年度公司实现营业收入 650,000 万元至 700,000 万元, 与上年同期相比, 增加 290,924.78 万元至 340,924.78 万元, 同比增长 81.02%至 94.95%。</p> <p><b>Q4. 请问公司 2024 年产生了约 4.5 亿的研发投入, 主要投入哪些方向?</b></p> <p>A4: 公司紧紧围绕半导体存储产业链, 持续加大对芯片设计、存储介质特性研究、固件/软件/硬件开发、存储测试设备与算法开发等领域的技术研发投入, 持续构建存储封测产能以满足业务增长需求并向晶圆级封测领域演进, 进一步增强公司的核心竞争力, 延伸公司的价值链条。</p> <p><b>Q5. 公司与 HP、Acer、Predator、Lenovo 等品牌的合作模式有什么竞争优势?</b></p> <p>A5: 公司先后获得惠普 (HP)、宏碁 (Acer)、掠夺者 (Predator) 等国际知名品牌的存储器产品全球运营授权及联想 (Lenovo) 在海外区域市场的存储器产品运营授权, 由公司独立进行相关产品的设计、研发、生产和市场推广、销售。在授权品牌运营方面, 公司有两大突出优势: 一方面公司拥有从产品规划、设计开发到先进制造的全栈能力, 产品线囊括 NAND、DRAM 的各个品类; 另一方面公司拥有覆盖全球主要市场的营销网络, 以及本地化的产品和市场营销队伍、经销商伙伴, 具备面向全球市场进行产品推广与销售的能力。</p> <p><b>Q6. 请问公司 2025 年有什么经营计划?</b></p> <p>A6: 公司将持续坚持“5+2+X”的发展战略, 在手机、PC、服务器等三大主要细分市场着力提升市场份额与核心竞争力, 力争实现与更多一线客户的深度合作; 在智能穿戴和工车规市场投入战略性资源, 力争成为主要参与者; 持续布局芯片设计和晶圆级先进封测, 打造公司二次增长曲线; 对存算一体、新接口、新介质和先进测试设备等创新领域进行探索与开拓。通过以上战略布局, 兼顾公司短/中/长期发展目标, 推动公司持续构建新质生产力, 提升公司的价值和股东回报。</p> <p><b>Q7. 公司产品已进入哪些国内外客户?</b></p> <p>A7: 公司产品在国内存储厂商中市场份额位居前列, 并已进入各细分领域国内外一线客户供应体系。在手机领域, 公司嵌入式存储产品进入 OPPO、传音控股、摩托罗拉、HMD、ZTE、TCL 等知名客户; 在 PC 领域, 公司 SSD 产品目前已经进入联想、Acer、HP、同方等国内外知名 PC 厂商; 在国产 PC 领域, 公司是 SSD 产品的主力供应商, 占据优势份额; 在智能穿戴领域, 公司产品已进入 Google、小米、Meta、小天才等国际知名智能穿戴厂商; 在车规领域, 公司产品正在导入国内头部车企及 Tier1 客户。</p> <p><b>Q8. 请问公司如何看待存储解决方案厂商的发展格局?</b></p>
--	--

	A8：目前产业正处于突破一线客户、主流应用的机遇期，行业竞争壁垒大幅提升，龙头企业的规模效应和技术优势壁垒会进一步加强，预计行业集中度将进一步提升。公司在品牌、技术、研发封测一体化构建和资本等方面均具备先发优势，将牢牢把握未来的产业发展趋势，持续构建品牌、规模和技术壁垒。
<b>附件清单</b>	无
<b>日期</b>	2025年2月19日-2月21日
<b>备注</b>	接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息披露等情况。